

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2023-050

## 通富微电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	9,907,892,175.21	9,567,157,644.65	3.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-187,693,998.98	365,415,659.40	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-261,421,813.66	311,006,497.21	不适用

经营活动产生的现金流量净额（元）	1,481,483,490.80	2,948,332,973.53	-49.75%
基本每股收益（元/股）	-0.1244	0.2762	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1243	0.2762	不适用
加权平均净资产收益率	-1.37%	3.44%	-4.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	34,081,783,858.95	35,629,428,284.40	-4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,548,226,257.35	13,833,578,689.66	-2.06%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	139,029		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	19.94%	301,941,893	0	质押	91,010,000
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	12.28%	185,949,913	0		
苏州园丰资本管理有限公司—苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	其他	4.35%	65,952,652	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.71%	56,220,775	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.53%	23,216,236	0		
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基	其他	1.35%	20,519,835	0		

金二期股份有限公司						
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05%	15,977,663	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	0.92%	13,888,700	0		
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	13,413,260	0		
交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.65%	9,876,956	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### （一）公司主要业务情况

公司是一家国内领先、世界先进的集成电路封装测试服务提供商，专注于为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式解决方案。公司的产品、技术、服务覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局七大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有近两万名员工。公司与客户紧密合作，在国家政策支持和市场拉动下，在系统厂家的需求牵引、产业链的协同发展、国家产业基金支持下，不断提升自主创新能力和核心竞争力，致力于成为国际级集成电路封测企业。

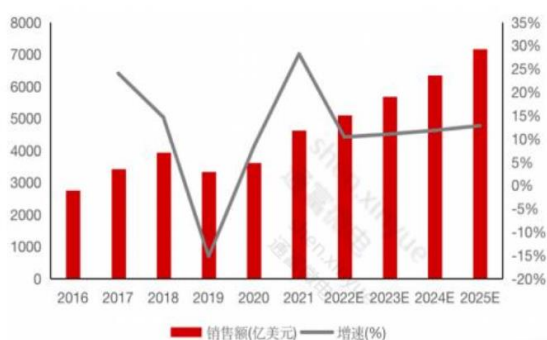
### （二）公司所处行业情况

#### 1、半导体市场情况

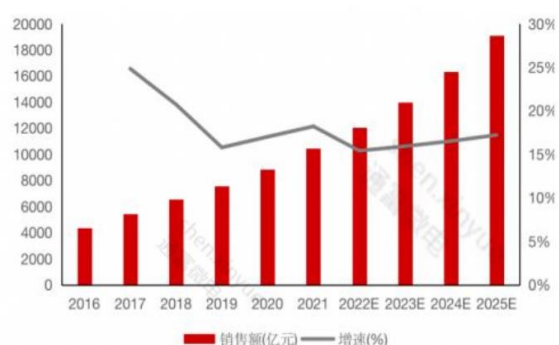
半导体是信息技术和电子产业的核心基础，其市场规模和发展趋势反映了全球经济和科技的变化。根据半导体行业协会(SIA)的数据，2023 年第一季度全球半导体销售额为 1,195 亿美元，较上季度下降 8.7%，较去年同期下降 21.3%；2023 年第二季度全球半导体销售额为 1,245 亿美元，环比增长 4.7%，同比减少 17.3%，其中，2023 年 6 月的全球销售额为 415 亿美元，比上月增长 1.7%，这是全球芯片销售额连续第四个月实现小幅上升。从 2023 年第二季度的数据看，全球半导体市场显示出回暖迹象。

集成电路是半导体产业的重要组成部分，其产业规模远超半导体其他细分领域，具备广阔的市场空间和增长潜力。赛迪顾问的报告预测，2025 年全球集成电路市场销售额可达 7,153 亿美元，2022 年至 2025 年期间保持 10% 以上的年均复合增长率。随着国产化率的不断提升以及终端市场需求的增加，到 2025 年中国大陆集成电路销售额将达到 19,098.80 亿元，较 2021 年增长 82.62%。长远来看，集成电路产业的发展，未来可期。

2016 年-2025 年全球集成电路市场销售额及增速



2016 年-2025 年中国大陆集成电路市场销售额及增速



资料来源：民生证券研究院

#### 2、公司行业地位

2022 年下半年全球半导体市场遭遇寒冬，封测业面临严峻挑战。根据芯思想研究院发布的 2022 年全球委外封测（OSAT）榜单，前十强的市场占有率进一步集中。公司 2022 年营收突破 200 亿元，同比增长 35.52%。在全球前十大封测企业中，公

司营收增速连续 3 年保持第一；2022 年，公司在全球前十大封测企业中市占率增幅第一，营收规模排名进阶，首次进入全球四强。

公司在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2.5D/3D 等顶尖封装技术。公司凭借上述差异化竞争优势，加强与行业领导企业的深度合作，提升客户满意度和忠诚度，进一步扩大市场份额。在 2023 年上半年全球半导体市场疲软，下游需求复苏不及预期的情况下，公司上半年实现营业收入 99.08 亿元，同比依然增长 3.56%。预计报告期内，公司行业地位未发生重大变化。

22排名	21排名	公司	地区	2021年	2022年	年增长%	2021市占率	2022市占率
1	1	日月光控股ASE	中国台湾	77240	85489	10.68%	26.90%	27.11%
2	2	安靠Amkor	美国	38606	44393	14.99%	13.44%	14.08%
3	3	长电科技JCET	中国大陆	30502	33778	10.74%	10.62%	10.71%
4	5	通富微电TFME	中国大陆	15812	20519	29.77%	5.51%	6.51%
5	4	力成科技PTI	中国台湾	18916	19277	1.91%	6.59%	6.11%
6	6	华天科技HUATIAN	中国大陆	12097	12127	0.25%	4.21%	3.85%
7	7	智路封测WiseRoad*	中国大陆	9146	10968	19.92%	3.19%	3.48%
8	8	京元电子KYEC	中国台湾	7788	8448	8.47%	2.71%	2.68%
9	10	顾邦Chipbond	中国台湾	6247	5515	-11.72%	2.18%	1.75%
10	9	南茂ChipMOS	中国台湾	6321	5401	-14.55%	2.20%	1.71%
前十大合计				222675	245915	10.44%	77.55%	77.98%
其他				64466	69435	7.71%	22.45%	22.02%
全球合计				287141	315350	9.82%	100.00%	100.00%

数据来源：芯思想研究院 2023年1月 单位：百万元人民币  
\*智路封测的营收包括UTAC和日月新半导体

### （三） 报告期公司经营情况

#### 1、积极调整、扬长补短，结构优化，营收增长。

2023 年上半年，全球半导体市场陷入低迷，终端市场需求疲软，下游需求低于预期，导致封测环节业务承压，公司传统业务遭遇较大挑战。面对困难，公司进一步优化传统封测市场和产品策略。一是紧跟手机等消费类市场变化，积极调整市场策略，稳定并提升了市场占有率；二是抓住 5G 高端手机对 RFFEM 等产品需求增长的机遇，借助成熟的系统级（SiP）封装技术和高性能的引线互联封装技术等，快速实现射频模组、通讯 SOC 芯片等产品大批量国产化生产，增加营收的同时也获得了来自 MTK、紫光展锐、卓胜微等重要头部企业的高度认可。

同时公司积极调整产品布局，立足市场最新技术前沿，在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长。2023 年上半年，公司实现营业收入 99.08 亿元，同比增长 3.56%。

随着 ChatGPT 等生成式 AI 应用出现，人工智能产业化进入新阶段，根据 AMD 预测，相关产业有望激发数据中心和 AI 加速器市场由今年 300 亿美元市场规模提升至 2026 年 1500 亿美元。今年 6 月，AMD 发布 AI 芯片 MI300，将极大提升各类生成式 AI 的大语言模型的处理速度。随着高性能运算和 AI 火爆需求的释放，拉动了新一轮先进封装需求的快速发展。围绕这一趋势，公司依托与 AMD 等行业龙头企业多年的合作累积，基于高端处理器和 AI 芯片封测需求的不断增长、先进封测技术的更新迭代等因素，为进一步提升公司在该领域的市场份额，通富超威槟城持续增加美元贷款，用于新建厂房，购买设备和原材料，特别是为未来扩大生产增加备料较多。上述情况，使得公司合并报表层面外币净敞口主要为美元负债，由于美元兑人民币汇率在 2023 年第二季度升值超过 5%致使公司产生较大汇兑损失，公司因汇兑损失减少归属于母公司股东的净利润 2.03 亿元左右，如剔除上述汇率波动影响，2023 年上半年公司归属于母公司股东的净利润为正。

上半年，公司在存储器（Memory）、显示驱动（Display Driver）、功率半导体（Power）等方面取得重要突破。随着国内存储芯片技术的日趋成熟以及国产面板在全球市场份额的提升，公司布局多年的存储器产线和显示驱动产线已稳步进入量产阶段并显著提升了公司在相关领域的市场份额。由于全球能源结构调整已成为必然趋势，而这一趋势也带动了功率半导体及大功率模块需求的持续增长。凭借在功率半导体封测领域的多年实践，上半年公司配合意法半导体（ST）等行业龙头，完成了碳化硅模块（SiC）自动化产线的研发并实现了规模量产，在光伏储能、新能源汽车电子等领域的封测市场份额得到了稳步提升。

上半年，公司凭借有效的成本控制，先进的技术管理能力以及快速响应和优质交付等方面的优异表现连续三年荣获德州仪器（TI）“卓越供应商”奖项。通富超威苏州获得多家客户 2023 半年度质量评分一级供应商称号，连续 5 次在 AMD 供

应商季度质量评分中获得第一名。合肥通富被多家重要客户评为 A 级优秀供应商。

目前，随着下游客户端库存水位的逐步下降，半导体行业下行周期已经触底，市场显示出回暖迹象。从公司营业收入数据来看，2023 年第二季度实现营业收入约 52.66 亿元，环比增长 13.45%，同比增长 3.97%，体现出业务复苏向好趋势。业内普遍预计封测市场在 2024 年将迎来全面反弹。

公司在汽车电子领域深耕 20 余年，与国际一流汽车半导体厂商深度合作，积累了丰富的相关经验，在汽车电子领域的份额占比保持领先，并逐年提升。公司以汽车电子新专线建设为抓手，进一步加大工程资源投入，优化产线管理体系，与国内外汽车电子客户共同成长。

公司将面向高端处理器等产品领域进一步加大研发力度：大力投资 2.5D/3D 等先进封装研发，积极拉通 Chiplet 市场化应用，提前布局更高品质、更高性能、更先进的封装平台，拓展先进封装产业版图，为新一轮的需求及业务增长夯实基础，带动公司在先进封装产品领域的业绩成长。

## 2、面向客户、人有我优，科技创新持续提升。

公司坚持客户导向型创新，从“人无我有”为主向“人有我优”为主转变，寻找跨边界耦合式创新点。2023 年上半年，围绕新技术研发、现有技术再升级等方面，公司持续开展以超大尺寸 F0 及 2.5D 技术为代表的新技术、新产品研发。截至目前，大尺寸 F0 及 2.5D 产品开发顺利推进，已进入产品考核阶段；3D 低成本技术方案稳步推进，完成工程验证；面向 8K 高清显示的双面散热 COF 产品完成开发，进入批量量产阶段；持续推进 5nm、4nm、3nm 新品研发，凭借 FCBGA、Chiplet 等先进封装技术优势，不断强化与客户的深度合作，满足客户 AI 算力等方面的需求。

上半年，公司完成业界领先的高集成、双面塑封 SIP 模组的技术开发，高阶手机射频前端模组 PAMiD 和 L-PAMiD 等多款产品以及高端可穿戴产品双面模组已进入大批量量产阶段；FC 技术开发方面，公司已具备超大尺寸芯片封装能力，初步完成先进 TIM（石墨烯等）材料开发；完成 Cu 底板塑封大功率模块的技术开发，实现了大功率模块的产品升级，在功率密度、散热及功耗等性能改善方面进一步得到了提升，现已进入大批量量产阶段；为行业头部企业开发的车载 MCU 也已通过考核并进入量产阶段。

截至上半年，公司累计申请专利 1,463 件，发明专利占比约 70%，其中《半导体封装结构形成的方法》（ZL201410061904.5）项目获评“江苏省优秀专利奖”。

## 3、项目建设、人才激励，促进公司长远发展。

2023 年上半年，通富通科、南通通富三期工程、通富超威苏州、通富超威槟城新工厂等一批公司重大项目建设稳步推进，施工面积合计约 27.3 万平方米，积极为未来扩大生产做好充足准备。

习总书记曾说，科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力，公司亦是如此。作为一家先进的现代化电子高科技企业，为了抓住行业发展机遇，公司不断吸纳多样化人才，为公司发展注入新的活力。2023 年上半年，公司进一步完善干部职工领导力的开发，制定科学的干部职工选拔标准；加强干部职工考核与反馈，对干部职工的履职进行定期评价交流，及时发现和解决具体问题；激发全体员工积极性，落实股票期权行权和员工持股计划解锁，推进核心、关键、骨干人才津贴。为支持公司可持续发展及吸引和留住优秀人才，将公司第一期员工持股计划中预留份额 1,672,786 股进行了分配。2023 年 6 月，公司股票期权第一个等待期届满且行权条件成就。同月，公司第一期员工持股计划第二个锁定期届满，达到解锁条件。股票期权激励计划及员工持股计划的开展，有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性、主动性和创造性，留住人才、激励人才，建立公司与员工双方利益共享和风险共担的长效机制，夯实公司业务发展的组织和人才基础，促进公司长远可持续发展。

通富微电子股份有限公司

董事长：石明达

2023 年 8 月 29 日